

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 6 月 7 日(07.06.2012)

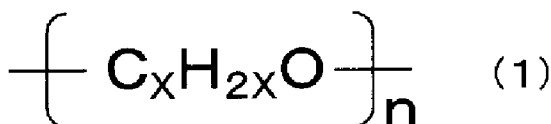


(10) 国際公開番号
WO 2012/073851 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 179/08 (2006.01) *C09J 163/00* (2006.01)
C09J 7/00 (2006.01) *C09J 183/10* (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) *H01L 23/36* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/077305
- (22) 国際出願日: 2011 年 11 月 28 日(28.11.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-268017 2010 年 12 月 1 日(01.12.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 嶋田彰(SHIMADA, Akira). 榛葉陽一(SHINBA, Yoichi). 野中敏央(NONAKA, Toshihisa).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告(条約第 21 条(3))

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, ADHESIVE SHEET, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING THE ADHESIVE COMPOSITION OR THE ADHESIVE SHEET

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、接着剤シートおよびこれらを用いた半導体装置



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide an adhesive composition, which has high thermal conductivity and excellent adhesion, and wherein dispersibility of a thermally conductive filler is controlled. The adhesive composition is configured to contain (A) a soluble polyimide, (B) an epoxy resin and (C) a thermally conductive filler. The adhesive composition is characterized in that the soluble polyimide (A) contains a structure represented by general formula (1) as a component derived from a diamine and the amount of the thermally conductive filler (C) contained in the adhesive composition is not less than 60% by volume. (In general formula (1), X represents an integer of 1-10 (inclusive) and n represents an integer of 1-20 (inclusive).)

(57) 要約: 本発明は、熱伝導性フィラーの分散性を制御し、高い熱伝導性と密着性に優れた接着剤組成物を提供することを目的としてなされたものであり、その構成は、(A)可溶性ポリイミド、(B)エポキシ樹脂、および(C)熱伝導性フィラーを含有する接着剤組成物であって、(A)可溶性ポリイミドが下記一般式(1)で示す構造をジアミンに由来する成分として含有し、接着剤組成物における(C)熱伝導性フィラーの含有量が60vol.%以上である接着剤組成物である。(一般式(1)中、Xは1以上10以下の整数、nは1以上20以下の整数を示す。)